

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-285122

(43)Date of publication of application : 12.10.2001

(51)Int. Cl.

H04B 1/40

H01P 1/15

H01P 1/213

(21)Application number : 2000-098848 (71)Applicant : MURATA MFG CO LTD

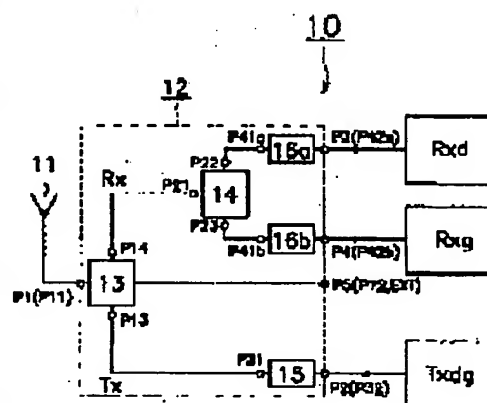
(22)Date of filing : 31.03.2000 (72)Inventor : TANAKA KOJI  
 FURUYA KOJI  
 WATANABE TAKAHIRO  
 MUTO HIDEKI  
 UEJIMA TAKANORI  
 NAKAJIMA NORIO

(54) MOBILE COMMUNICATION EQUIPMENT AND HIGH FREQUENCY COMPOSITE PART TO BE USED FOR IT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide mobile communication equipment of which the circuit is minimized by reducing the number of parts and a high frequency composite part to be used for it.

SOLUTION: The mobile communication equipment 10 is a dual band portable telephone set having two communication systems corresponding to different frequencies, which are a DCS system being the communication system of 1.8 GHz band and a GSM system being the communication system of 900 MHz, and includes an antenna 11, the high frequency composite part 12, a transmission part Txdg and receiving parts Rxd and Rxg. Then, the parts 12 consist of first to fifth ports P1 to P5, a 4-port high frequency switch 13, a diplexer 14, an LC filter 15, a surface acoustic wave filters 16a and 16b.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号  
特開2001-285122  
(P2001-285122A)

(43) 公開日 平成13年10月12日 (2001.10.12)

(51)Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テ-マ-ト*(参考)	
H 0 4 B	1/40	H 0 4 B	1/40	5 J 0 0 6
H 0 1 P	1/15	H 0 1 P	1/15	5 J 0 1 2
	1/213		1/213	M 5 K 0 1 1

審査請求 未請求 請求項の数5 O L (全 9 頁)

(21) 出願番号 特願2000-98848(P2000-98848)

(22) 出願日 平成12年3月31日 (2000.3.31)

(71) 出願人 000006231

株式会社村田製作所

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

(72) 発明者 田中 浩二

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式  
会社村田製作所内

(72) 発明者 降谷 孝治

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式  
会社村田製作所内

(72) 発明者 渡辺 貴洋

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式  
会社村田製作所内

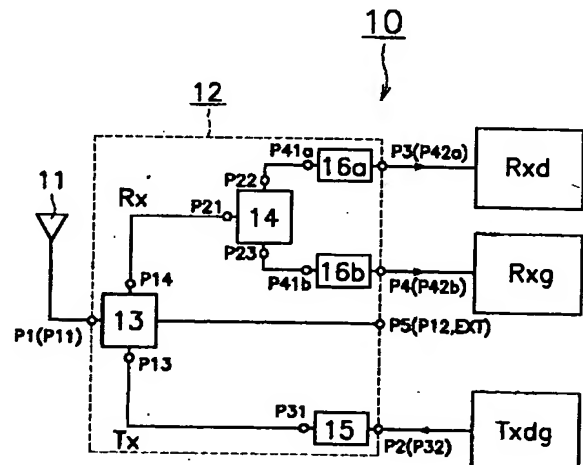
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 移動体通信装置及びそれに用いる高周波複合部品

(57) 【要約】

【課題】 部品点数を少なくし、回路の小型化を可能した移動体通信装置及びそれに用いる高周波複合部品を提供する。

【解決手段】 移動体通信装置10は、異なる周波数に対応した2つの通信システム、すなわち1.8GHz帯の通信システムであるDCS系と900MHz帯の通信システムであるGSM系とを有するデュアルバンド携帯電話器であり、アンテナ11、高周波複合部品12、送信部Tx dg及び受信部Rx d、Rx gを含む。そして、高周波複合部品12は、第1～第5のポートP1～P5、4ポート高周波スイッチ13、ダイプレクサ14、LCフィルタ15及び弾性表面波フィルタ16a、16bからなる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 異なる周波数に対応した送信部及び受信部を備えた複数の通信システムを有し、アンテナを介して受信した受信信号を前記複数の通信システムへ振り分けるダイプレクサと、前記複数の通信システムを前記送信部と前記受信部とに分離する4ポート高周波スイッチとを含むことを特徴とする移動体通信装置。

【請求項2】 前記4ポート高周波スイッチを、前記アンテナと前記ダイプレクサとの間に配設したことを特徴とする請求項1に記載の移動体通信装置。

【請求項3】 前記ダイプレクサを、前記アンテナと前記4ポート高周波スイッチとの間に配設し、前記複数の通信システムそれぞれに前記4ポート高周波スイッチを備えたことを特徴とする請求項3に記載の移動体通信装置。

【請求項4】 請求項1乃至請求項3に記載の移動体通信装置に用いられ、前記複数の通信システムにおけるマイクロ波回路の一部を構成する高周波複合部品であって、

前記ダイプレクサ及び前記4ポート高周波スイッチを、複数の誘電体層を積層してなる多層基板で構成したことを特徴とする高周波複合部品。

【請求項5】 前記ダイプレクサを、インダクタンス素子及びキャパシタンス素子で構成し、前記4ポート高周波スイッチを、スイッチング素子、インダクタンス素子及びキャパシタンス素子で構成するとともに、前記スイッチング素子、前記インダクタンス素子及び前記キャパシタンス素子が、前記多層基板に搭載、あるいは内蔵され、前記多層基板の内部に形成された接続手段によって接続されたことを特徴とする請求項4に記載の高周波複合部品。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、移動体通信装置及びそれに用いる高周波複合部品に関し、特に、複数の異なる移動体通信システムに利用可能な移動体通信装置及びそれに用いる高周波複合部品に関する。

## 【0002】

【従来の技術】現在、ヨーロッパでは、移動体通信装置として、複数の周波数帯域、例えば1.8GHz帯を使用したDCS(Digital Cellular System)と900MHz帯を使用したGSM(Global System for Mobile communications)とで動作が可能なデュアルバンド携帯電話器が提案されている。

【0003】図7は、一般的なデュアルバンド携帯電話器の構成の一部を示すブロック図であり、1.8GHz帯のDCSと900MHz帯のGSMとを組み合わせた一例を示したものである。デュアルバンド携帯電話器50は、アンテナ1、ダイプレクサ2、及び2つの通信システムDCS系、GSM系を備える。

【0004】ダイプレクサ2は、2つの通信システムDCS系、GSM系からの送信信号をアンテナ1へ送出するとともに、アンテナ1を介して受信した受信信号を2つの通信システムDCS系、GSM系へ振り分ける役目を担う。DCS系は、送信部Tx dと受信部Rx dとに分離する3ポート高周波スイッチ3a、及びダイプレクサ2と3ポート高周波スイッチ3aとの間に配置される低域通過フィルタ4aからなり、GSM系は、送信部Tx gと受信部Rx gとに分離する3ポート高周波スイッチ3b、及びダイプレクサ2と3ポート高周波スイッチ3bとの間に配置される低域通過フィルタ4bからなる。低域通過フィルタ4a、4bは送信信号の2次高調波及び3次高調波を除去する役目を担う。

【0005】しかしながら、図7の構成のデュアルバンド携帯電話器では、外部端子を備えていないため、自動車内で使用する際に感度の良い車載アンテナに接続できないといった問題や出荷時に受信部の性能を評価できないといった問題などがあった。

【0006】図8は、上記の問題を解決するために提案されたデュアルバンド携帯電話器の構成の一部を示すブロック図である。デュアルバンド携帯電話器60は、図7のデュアルバンド携帯電話器50と比較して、外部端子EXTを設けるために、アンテナ1とダイプレクサ2との間に3ポート高周波スイッチ5を配設している点で異なる。

## 【0007】

【発明が解決しようとする課題】ところが、上記従来の移動体通信装置の1つであるデュアルバンド携帯電話器によれば、送信部と受信部との切り換え、及び外部端子への切り換えを別々の3ポート高周波スイッチで行っているため、部品点数が増加し、その結果、デュアルバンド携帯電話器(移動体通信装置)が大型化するという問題があった。

【0008】また、アンテナ、ダイプレクサ、並びにDCS系、GSM系を構成する3ポート高周波スイッチ及び高周波フィルタがディスクリートで1つ、1つ回路基板上に実装されるため、整合特性、減衰特性、あるいはアイソレーション特性を確保するために、ダイプレクサと高周波フィルタとの間、高周波フィルタと3ポート高周波スイッチとの間に整合回路を付加する必要がある。そのため、部品点数の増加、それにとまう実装面積の増加により、回路基板が大型化し、その結果、デュアルバンド携帯電話器(移動体通信装置)が大型化するという問題もあった。

【0009】本発明は、このような問題点を解決するためになされたものであり、部品点数を少なくし、回路の小型化を可能にした移動体通信装置及びそれに用いる高周波複合部品を提供することを目的とする。

## 【0010】

【課題を解決するための手段】上述する問題点を解決す

るため本発明の移動体通信装置は、異なる周波数に対応した送信部及び受信部を備えた複数の通信システムを有し、アンテナを介して受信した受信信号を前記複数の通信システムへ振り分けるダイプレクサと、前記複数の通信システムを前記送信部と前記受信部とに分離する4ポート高周波スイッチとを含むことを特徴とする。

【0011】また、本発明の移動体通信装置は、前記4ポート高周波スイッチを、前記アンテナと前記ダイプレクサとの間に配設したことを特徴とする。

【0012】また、本発明の移動体通信装置は、前記ダイプレクサを、前記アンテナと前記4ポート高周波スイッチとの間に配設し、前記複数の通信システムそれぞれに前記4ポート高周波スイッチを備えたことを特徴とする。

【0013】本発明の高周波複合部品は、上述の移動体通信装置に用いられ、前記複数の通信システムにおけるマイクロ波回路の一部を構成する高周波複合部品であって、前記ダイプレクサ及び前記4ポート高周波スイッチを、複数の誘電体層を積層してなる多層基板で構成したことを特徴とする。

【0014】また、本発明の高周波複合部品は、前記ダイプレクサを、インダクタンス素子及びキャパシタンス素子で構成し、前記4ポート高周波スイッチを、スイッチング素子、インダクタンス素子及びキャパシタンス素子で構成するとともに、前記スイッチング素子、前記インダクタンス素子及び前記キャパシタンス素子が、前記多層基板に搭載、あるいは内蔵され、前記多層基板の内部に形成された接続手段によって接続されたことを特徴とする。

【0015】本発明の移動体通信装置によれば、4ポート高周波スイッチを用いているため、送信部と受信部との切り換え、及び外部端子への切り換えを同一の4ポート高周波スイッチで行うことが可能となり、部品点数を少なくすることができる。

【0016】本発明の高周波複合部品によれば、ダイプレクサ及び4ポート高周波スイッチを、複数の誘電体層を積層してなる多層基板で構成したため、ダイプレクサ及び4ポート高周波スイッチの各接続を多層基板の内部に設けることができる。

【0017】

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。図1は、本発明の移動体通信装置に係る第1の実施例のブロック図である。移動体通信装置10は、異なる周波数に対応した2つの通信システム、すなわち1.8GHz帯の通信システムであるDCS系と900MHz帯の通信システムであるGSM系とを有するデュアルバンド携帯電話器であり、アンテナ11、高周波複合部品12（図1中破線で囲んだ部分）、送信部Tx d g及び受信部Rx d, Rx gを含む。

【0018】そして、高周波複合部品12は、第1～第

5のポートP1～P5、4ポート高周波スイッチ13、ダイプレクサ14、LCフィルタ15及び弾性表面波フィルタ16 a, 16 bからなる。

【0019】この際、4ポート高周波スイッチ13は、送信Tx側からの送信信号をアンテナ11へ送出するとともに、アンテナ11を介して受信した受信信号を受信Rx側へ送出する役目を担う。また、ダイプレクサ14は、4ポート高周波スイッチ13から送出された受信信号を2つの通信システムDCS系、GSM系へ振り分ける役目を担う。

【0020】さらに、LCフィルタ15は、送信部Tx d gを構成する送信電力増幅器（図示せず）の高調波歪みを除去する目的で、4ポート高周波スイッチ13と送信部Tx d gとの間に配置される。また、弾性表面波フィルタ16 a, 16 bは、受信信号以外の信号、例えばイメージ信号や局部発振信号を除去する目的で、ダイプレクサ14と受信部Rx d, Rx gとの間にそれぞれ配置される。

【0021】さらに、第1及び第5のポートP1, P5には4ポート高周波スイッチ13の第1及び第2ポートP11, P12が、第2のポートP2にはLCフィルタ15の第2ポートP32が、第3及び第4のポートP3, P4には弾性表面波フィルタ16 a, 16 bの第2ポートP42 a, P42 bがそれぞれ接続される。

【0022】また、4ポート高周波スイッチ13の第3ポートP13はLCフィルタ15の第1ポートP31に接続され、4ポート高周波スイッチ13の第4ポートP14はダイプレクサ14の第1ポートP21に接続される。さらに、ダイプレクサ14の第2及び第3ポートP22, P23は弾性表面波フィルタ16 a, 16 bの第1ポートP41 a, P41 bにそれぞれ接続される。

【0023】以上のような構成の高周波複合部品12において、第1のポートP1にはアンテナ11が、第2のポートP2にはDCS系及びGSM系共通の送信部Tx d gが、第3のポートP3にはDCS系の受信部Rx dが、第4のポートP4にはGSM系の受信部Rx gがそれぞれ接続され、第5のポートP5は外部端子EXTとなる。

【0024】図2は、図1に示す高周波複合部品を構成する4ポート高周波スイッチの回路図である。4ポート高周波スイッチ13は、スイッチング素子であるダイオードD1～D4、インダクタンス素子であるインダクタL11～L14、キャパシタンス素子であるコンデンサC11～C14、及び抵抗R1～R4で構成される。

【0025】第1、第3ポートP11, P13間にダイオードD1が、第1、第4ポートP11, P14間にダイオードD2が、第2、第3ポートP12, P13間にダイオードD3が、第2、第4ポートP12, P14間にダイオードD4がそれぞれ接続される。すなわち、ダイオードD1～D4は、図2のようにリング状に接続さ

れており、かつそのリング状回路部分の周方向において同じ向きに接続されている。

【0026】第1ポートP11は、ダイオードD1のアノード及びダイオードD2のカソードに接続される。第1ポートP11とダイオードD1、D2との間の接続点は、インダクタL11とコンデンサC11とからなる直列回路を介して接地される。また、インダクタL11とコンデンサC11との間の接続点は、抵抗R1を介して制御端子V1に接続される。

【0027】第2ポートP12は、ダイオードD3のカソード及びダイオードD4のアノードに接続される。第2ポートP12とダイオードD3、D4との間の接続点は、インダクタL12とコンデンサC12とからなる直列回路を介して接地される。また、インダクタL12とコンデンサC12との間の接続点は、抵抗R2を介して制御端子V1に接続される。

【0028】第3ポートP13は、ダイオードD1のカソード及びダイオードD3のアノードに接続される。第3ポートP13とダイオードD1、D3との間の接続点は、インダクタL13とコンデンサC13とからなる直列回路を介して接地される。また、インダクタL13とコンデンサC13との間の接続点は、抵抗R3を介して制御端子V2に接続される。

【0029】第1ポートP14は、ダイオードD2のアノード及びダイオードD4のカソードに接続される。第4ポートP14とダイオードD2、D4との間の接続点は、インダクタL14とコンデンサC14とからなる直列回路を介して接地される。また、インダクタL14とコンデンサC14との間の接続点は、抵抗R4を介して制御端子V2に接続される。

【0030】図3は、図1に示す高周波複合部品を構成するダイプレクサの回路図である。ダイプレクサ14は、インダクタンス素子であるインダクタL21、L22、及びキャパシタンス素子であるコンデンサC21～C25で構成され、第1ポートP21と第2ポートP22との間にコンデンサC21、C22が直列接続され、この接続点がインダクタL21とコンデンサC23とからなる直列回路を介して接地される。

【0031】また、第1ポートP21と第3ポートP23との間にインダクタL22とコンデンサC24とからなる並列回路が接続され、その並列回路の第3ポートP23側がコンデンサC25を介して接地される。

【0032】すなわち、第1ポートP21と第2ポートP22との間には、高域通過フィルタが構成され、第2のポートP22に接続されたDCS系（高域側）の受信信号だけを通過させる通過帯域を有している。

【0033】また、第1ポートP21と第3ポートP23との間には、低域通過フィルタが構成され、第3のポートP23に接続されたGSM系（低域側）の受信信号だけを通過させる通過帯域を有している。

【0034】図4は、図1に示す高周波複合部品を構成するLCフィルタの回路図である。LCフィルタ15は、インダクタンス素子であるインダクタL31及びキャパシタンス素子であるコンデンサC31、C32で構成され、第1ポートP31と第2ポートP32との間にインダクタL31とコンデンサC31とからなる並列回路が接続される。また、その並列回路の第2ポートP32側がコンデンサC32を介して接地される。

【0035】図5は、図1に示す高周波複合部品の具体的な構成を示す一部分斜視図である。高周波複合部品12は、複数の誘電体層を積層してなる多層基板17を含む。

【0036】そして、多層基板17には、図示していないが、4ポート高周波スイッチ13（図2参照）を構成するインダクタL11～L14及びコンデンサC11～C14、ダイプレクサ14（図3参照）を構成するインダクタL21、L22及びコンデンサC21～C25、並びにLCフィルタ15（図4参照）を構成するインダクタL31及びコンデンサC31、C32がそれぞれ内蔵される。

【0037】また、多層基板17の表面には、4ポート高周波スイッチ13（図2参照）を構成するダイオードD1～D4及び抵抗R1～R4、並びに弾性表面波フィルタ16a、16bがそれぞれ搭載される。

【0038】さらに、ダイオードD1～D4、インダクタL11～L14、L21、L22、L31、コンデンサC11～C14、C21～C25、C31、C32、抵抗R1～R4、及び弾性表面波フィルタ16a、16bは、それぞれ多層基板17の内部でビアホール電極（図示せず）等により接続される。その結果、4ポート高周波スイッチ13とダイプレクサ14、4ポート高周波スイッチ13とLCフィルタ15、ダイプレクサ14と弾性表面波フィルタ16a、16bとが、それぞれ多層基板17の内部でビアホール電極（図示せず）等により接続されることになる。

【0039】また、多層基板17の側面から底面にかけて、12個の端子Ta～Tlがスクリーン印刷などでそれぞれ形成され、それぞれ高周波複合部品12の第1～第5のポートP1～P5、高周波複合部品12を構成する4ポート高周波スイッチ13の制御端子V1、V2、及びグランドとなる。

【0040】さらに、多層基板17上には、多層基板17上に搭載した各部品を覆うとともに、相対する短辺の突起部181、182がグランドとなる端子Tf、Tiに当接するように、金属キャップ18が被せられる。

【0041】ここで、図1の移動体通信装置10を構成する高周波複合部品12の動作について説明する。まず、DCS系（1.8GHz帯）あるいはGSM系（900MHz帯）の送信信号を送信する場合には、4ポート高周波スイッチ13において制御端子V1に3Vを印

加してダイオードD1、D4をオン状態にして、4ポート高周波スイッチ13の第1ポートP11-第3ポートP13間を接続状態にすることにより、送信部Tx dgからの送信信号がLCフィルタ15及び4ポート高周波スイッチ13を通過し、高周波複合部品12の第1のポートP1に接続されたアンテナANTから送信される。

【0042】この際、制御端子V2に0Vを印加してダイオードD2、D3をオフ状態にすることにより、4ポート高周波スイッチ13の第1ポートP11-第4ポートP14間を非接続状態にして、送信信号が受信Rx側10に回り込まないようにしている。また、送信Tx側に配設されたLCフィルタ15では、送信部Tx dgを構成する高出力増幅器(図示せず)による送信信号の歪みを減衰させている。

【0043】次いで、DCS系の受信信号を受信する場合には、4ポート高周波スイッチ13において制御端子V2に3Vを印加してダイオードD2、D3をオンすることにより、4ポート高周波スイッチ13の第1ポートP11-第4ポートP14間を接続状態にすることにより、アンテナANTで受信したDCS系の受信信号が420ポート高周波スイッチ13、ダイプレクサ14及び弾性表面波フィルタ16aを通過し、高周波複合部品12の第3のポートP3に接続された受信部Rx dへ送られる。

【0044】この際、ダイプレクサ14により、DCS系の受信信号がGSM系の受信部Rx gに回り込まないようにしている。また、制御端子V1に0Vを印加してダイオードD1、D4をオフすることにより、4ポート高周波スイッチ13の第1ポートP11-第3ポートP13間を非接続状態にして、受信信号が送信Tx側に回30り込まないようにしている。さらに、ダイプレクサ14と受信部Rx dとの間に配設された弾性表面波フィルタ16aでは受信信号の第2高調波及び第3高調波を減衰させている。

【0045】次いで、GSM系の受信信号を受信する場合にも、同様に、4ポート高周波スイッチ13において制御端子V2に3Vを印加してダイオードD2、D3をオンすることにより、4ポート高周波スイッチ13の第1ポートP11-第4ポートP14間を接続状態にすることにより、アンテナANTで受信したGSM系の受信30信号が4ポート高周波スイッチ13、ダイプレクサ14及び弾性表面波フィルタ16bを通過し、高周波複合部品12の第4のポートP4に接続された受信部Rx gへ送られる。

【0046】この際、ダイプレクサ14により、GSM系の受信信号がDCS系の受信部Rx dに回り込まないようにしている。また、制御端子V1に0Vを印加してダイオードD1、D4をオフすることにより、4ポート高周波スイッチ13の第1ポートP11-第3ポートP13間を非接続状態にして、受信信号が送信Tx側に回40

り込まないようにしている。さらに、ダイプレクサ14と受信部Rx gとの間に配設された弾性表面波フィルタ16bでは、受信信号の第2高調波及び第3高調波を減衰させている。

【0047】上述した第1の実施例の移動体通信装置によれば、4ポート高周波スイッチを用いているため、送信部と受信部との切り換え、及び外部端子への切り換えを同一の高周波スイッチで行うことが可能となり、部品点数を少なくすることができる。したがって、自動車内で使用する際に感度の良い車載アンテナに接続できたり、出荷時に受信部の性能を評価できる小型の移動体通信装置が提供できる。

【0048】また、4ポート高周波スイッチを、アンテナとダイプレクサとの間に配設したため、1つの4ポート高周波スイッチで移動体通信装置を構成することができるため、移動体通信装置のさらなる小型化が可能である。

【0049】さらに、LCフィルタが4ポート高周波スイッチの後段の送信部側に接続されるため、送信部を構成する高出力増幅器による送信信号の歪みを減衰させることができる。したがって、送信部の挿入損失を改善することができ、送受信性能に優れた移動体通信装置を提供できる。

【0050】上述した実施例の高周波複合部品によれば、ダイプレクサ及び高周波スイッチを、複数の誘電体層を積層してなる多層基板を用いて構成したため、ダイプレクサ及び高周波スイッチの各接続を多層基板内部でおこなうことができる。したがって、高周波複合部品の小型化が図れるとともに、この高周波複合部品を搭載する移動体通信装置の小型化が図れる。

【0051】また、ダイプレクサ、4ポート高周波スイッチ、LCフィルタ及び弾性表面波フィルタを、複数の誘電体層を積層してなる多層基板を用いて構成したため、4ポート高周波スイッチとダイプレクサとの間、4ポート高周波スイッチとLCフィルタとの間、ダイプレクサと弾性表面波フィルタとの間の整合調整が容易となり、4ポート高周波スイッチとダイプレクサとの間、4ポート高周波スイッチとLCフィルタとの間、ダイプレクサと弾性表面波フィルタとの間の整合調整を行なう整合回路が不要となる。したがって、高周波複合部品の小型化が可能となる。

【0052】さらに、ダイプレクサがインダクタ及びコンデンサで構成され、4ポート高周波スイッチがダイオード、インダクタ及びコンデンサで構成され、LCフィルタがインダクタ及びコンデンサで構成されるとともに、それらが多層基板に内蔵、あるいは搭載され、多層基板の内部に形成される接続手段によって接続されるため、部品間の配線による損失を改善することができる。したがって、高周波複合部品全体の損失を改善することが可能となるにとともに、この高周波複合部品を搭載す50

る移動体通信装置の高性能化も同時に実現できる。

【0053】また、ダイプレクサ及び4ポート高周波スイッチを構成するインダクタを、ストリップライン電極として多層基板に内蔵する場合には、波長短縮効果により、インダクタとなるストリップライン電極の長さを短縮することができる。したがって、これらのストリップライン電極の挿入損失を向上させることができ、高周波複合部品の小型化及び低損失化を実現することができる。その結果、この高周波複合部品を搭載する移動体通信装置の小型化及び高性能化も同時に実現できる。

【0054】図6は、本発明の移動体通信装置に係る第2の実施例のブロック図である。移動体通信装置20は、異なる周波数に対応した2つの通信システム、すなわち1.8GHz帯の通信システムであるDCS系と900MHz帯の通信システムであるGSM系とを有するデュアルバンド携帯電話器であり、アンテナ11、高周波複合部品21(図6中破線で囲んだ部分)、送信部Tx d、Tx g及び受信部Rx d、Rx gを含む。

【0055】そして、高周波複合部品21は、第1～第7のポートP1～P7、4ポート高周波スイッチ13 a、13 b、ダイプレクサ14、LCフィルタ15 a、15 b及び弾性表面波フィルタ16 a、16 bからなる。

【0056】この際、ダイプレクサ14は、2つの通信システムDCS系、GSM系からの送信信号をアンテナ11へ送出するとともに、アンテナ11を介して受信した受信信号を2つの通信システムDCS系、GSM系へ振り分ける役目を担う。また、4ポート高周波スイッチ13は、2つの通信システムDCS系、GSM系を送信部Tx d、Tx gと受信部Rx d、Rx gとに分離する役目を担う。

【0057】さらに、LCフィルタ15 a、15 bは、送信部Tx d、Tx gを構成する送信電力増幅器(図示せず)の高調波歪みを除去する目的で、4ポート高周波スイッチ13 a、13 bと送信部Tx d、Tx gとの間に配置される。また、弾性表面波フィルタ16 a、16 bは、受信信号の2次高調波及び3次高調波を除去する目的で、4ポート高周波スイッチ13 a、13 bと受信部Rx d、Rx gとの間にそれぞれ配置される。

【0058】さらに、第1のポートP1にはダイプレクサ14の第1ポートP21が、第2及び第5のポートP2、P5にはLCフィルタ15 a、15 bの第2ポートP32 a、P32 bが、第3及び第6のポートP3、P6には弾性表面波フィルタ16 a、16 bの第2ポートP42 a、P42 bが、第4及び第7のポートP4、P7には4ポート高周波スイッチ13 a、13 bの第2ポートP12 a、P12 bがそれぞれ接続される。

【0059】また、ダイプレクサ14の第2及び第3ポートP22、P23は4ポート高周波スイッチ13 a、13 bの第1ポートP11 a、P11 bにそれぞれ接続

される。さらに、4ポート高周波スイッチ13 a、13 bの第3ポートP13 a、P13 bはLCフィルタ15 a、15 bの第1ポートP31 a、P31 bにそれぞれ接続され、4ポート高周波スイッチ13 a、13 bの第4ポートP14 a、P14 bは弾性表面波フィルタ16 a、16 bの第1ポートP41 a、P41 bにそれぞれ接続される。

【0060】以上のような構成の高周波複合部品21において、第1のポートP1にはアンテナ11が、第2のポートP2にはDCS系の送信部Tx dが、第3のポートP3にはDCS系の受信部Rx dが、第5のポートP5にはGSM系の送信部Tx gが、第6のポートP6にはGSM系の受信部Rx gがそれぞれ接続され、第4及び第7のポートP4、P7は外部端子EXT1、EXT2となる。

【0061】なお、4ポート高周波スイッチ13 a、13 bの回路は、図2で示した4ポート高周波スイッチ13と同じ構成をしており、LCフィルタ15 a、15 bの回路は、図4で示したLCフィルタ15と同じ構成をしているので、詳細な説明は省略する。

【0062】ここで、図6の移動体通信装置20を構成する高周波複合部品21の動作について説明する。まず、DCS系(1.8GHz帯)の送信信号を送信する場合には、4ポート高周波スイッチ13 aにおいて制御端子V1に3Vを印加してダイオードD1、D4をオン状態にして、4ポート高周波スイッチ13 aの第1ポートP11～第3ポートP13間を接続状態にすることにより、高周波複合部品21の第2のポートP2に接続された送信部Tx dからの送信信号がLCフィルタ15 a、4ポート高周波スイッチ13 a及びダイプレクサ14を通過し、高周波複合部品21の第1のポートP1に接続されたアンテナANTから送信される。

【0063】この際、4ポート高周波スイッチ13 aにおいて制御端子V2に0Vを印加してダイオードD2、D3をオフ状態にすることにより、4ポート高周波スイッチ13 aの第1ポートP11～第4ポートP14間を非接続状態にすることにより、送信信号が受信部Rx dに回り込まないようにしている。また、ダイプレクサ14により、DCS系の送信信号がGSM系に回り込まないようにしている。さらに、4ポート高周波スイッチ13 aと送信部Tx dとの間に配設されたLCフィルタ15 aでは送信部Tx dを構成する高出力増幅器(図示せず)による送信信号の歪みを減衰させている。

【0064】次いで、DCS系の受信信号を受信する場合には、4ポート高周波スイッチ13 aにおいて制御端子V2に3Vを印加してダイオードD2、D3をオンすることにより、4ポート高周波スイッチ13 aの第1ポートP11 a～第4ポートP14 a間を接続状態にすることにより、アンテナANTで受信したDCS系の受信信号がダイプレクサ14、4ポート高周波スイッチ13



a及び弾性表面波フィルタ16aを通過し、高周波複合部品21の第3のポートP3に接続された受信部Rxdへ送られる。

【0065】この際、制御端子V1に0Vを印加してダイオードD1、D4をオフすることにより、4ポート高周波スイッチ13aの第1ポートP11a-第3ポートP13a間を非接続状態にして受信信号が送信部Tx dに回り込まないようにしている。また、ダイプレクサ14により、DCS系の受信信号がGSM系に回り込まないようにしている。さらに、4ポート高周波スイッチ13aと受信部Rxdとの間に配設された弾性表面波フィルタ16aでは受信信号の第2高調波及び第3高調波を減衰させている。

【0066】なお、GSM系(900MHz帯)の送信信号を送信する場合、あるいは受信信号を受信する場合についても同様の方法で行う。

【0067】上述した第2の実施例の移動体通信装置によれば、4ポート高周波スイッチを用いているため、送信部と受信部との切り換え、及び外部端子への切り換えを同一の高周波スイッチで行うことが可能となり、部品点数を少なくすることができる。したがって、自動車内で使用する際に感度の良い車載アンテナに接続できたり、出荷時に受信部の性能を評価できる小型の移動体通信装置が提供できる。

【0068】また、ダイプレクサを、アンテナと4ポート高周波スイッチとの間に配設し、DCS系及びGSM系それぞれに4ポート高周波スイッチを備えたため、出荷時に個々に各通信システムの受信部の性能を評価できる。

【0069】なお、上記の第1及び第2の実施例の移動体通信装置において、複数の通信システムが、DCS系とGSM系との組み合わせである場合について説明したが、その使用は、DCS系とGSM系との組み合わせに限定されるものではなく、例えば、PCS(Personal Communication Services)系とAMPS(Advanced Mobile Phone Services)系との組み合わせ、DECT(Digital European Cordless Telephone)系とGSM系との組み合わせ、PHS(Personal Handy-phone System)系とPDC(Personal Digital Cellular)系との組み合わせ、などに使用することができる。

【0070】また、2つの通信システムを有する場合について説明したが、3つの以上の通信システムを有する場合についても同様の効果が得られる。

【0071】さらに、移動体通信装置を構成する高周波複合部品が多層基板上で構成される場合について説明したが、ディスクリート部品を回路基板に実装することにより構成しても移動体通信装置に関しては同様の効果が得られる。

【0072】

【発明の効果】請求項1の移動体通信装置によれば、4

ポート高周波スイッチを用いているため、送信部と受信部との切り換え、及び外部端子への切り換えを同一の高周波スイッチで行うことが可能となり、部品点数を少なくすることができる。したがって、自動車内で使用する際に感度の良い車載アンテナに接続できたり、出荷時に受信部の性能を評価できる小型の移動体通信装置が提供できる。

【0073】請求項2の移動体通信装置によれば、4ポート高周波スイッチを、アンテナとダイプレクサとの間に配設したため、1つの4ポート高周波スイッチで移動体通信装置を構成することができるため、移動体通信装置のさらなる小型化が可能である。

【0074】請求項3の移動体通信装置によれば、ダイプレクサを、アンテナと4ポート高周波スイッチとの間に配設し、DCS系及びGSM系それぞれに4ポート高周波スイッチを備えたため、出荷時に個々に各通信システムの受信部の性能を評価できる。

【0075】請求項4の高周波複合部品によれば、ダイプレクサ及び4ポート高周波スイッチを、複数の誘電体層を積層してなる多層基板を用いて構成したため、ダイプレクサ及び4ポート高周波スイッチの各接続を多層基板内部でおこなうことができる。したがって、高周波複合部品の小型化が図れるとともに、この高周波複合部品を搭載する移動体通信装置の小型化が図れる。

【0076】また、ダイプレクサ及び4ポート高周波スイッチを、複数の誘電体層を積層してなる多層基板を用いて構成したため、4ポート高周波スイッチとダイプレクサとの間の整合調整が容易となり、4ポート高周波スイッチとダイプレクサとの間の整合調整を行なう整合回路が不要となる。したがって、高周波複合部品の小型化が可能となる。

【0077】請求項5の高周波複合部品によれば、ダイプレクサがインダクタンス素子及びキャパシタンス素子で構成され、4ポート高周波スイッチがスイッチング素子、インダクタンス素子及びキャパシタンス素子で構成されるときともに、それらが多層基板に内蔵、あるいは搭載され、多層基板の内部に形成される接続手段によって接続されるため、部品間の配線による損失を改善することができる。したがって、高周波複合部品全体の損失を改善することが可能となるにともない、この高周波複合部品を搭載する移動体通信装置の高性能化も同時に実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の移動体通信装置に係る第1の実施例のブロック図である。

【図2】図1に示す高周波複合部品を構成する4ポート高周波スイッチの回路図である。

【図3】図1に示す高周波複合部品を構成するダイプレクサの回路図である。

【図4】図1に示す高周波複合部品を構成するLCフィ



ルタの回路図である。

【図5】図1に示す高周波複合部品の具体的な構成を示す一部分解斜視図である。

【図6】本発明の移動体通信装置に係る第2の実施例のブロック図である。

【図7】一般的なデュアルバンド携帯電話器（移動体通信装置）の構成を示すブロック図である。

【図8】一般的なデュアルバンド携帯電話器（移動体通信装置）の別の構成を示すブロック図である。

【符号の説明】

10, 20 移動体通信装置

11 アンテナ

12 高周波複合部品

13, 13a, 13b 4ポート高周波スイッチ

14 ダイプレクサ

17 多層基板

C11~C14, C21~C25, C31, C32

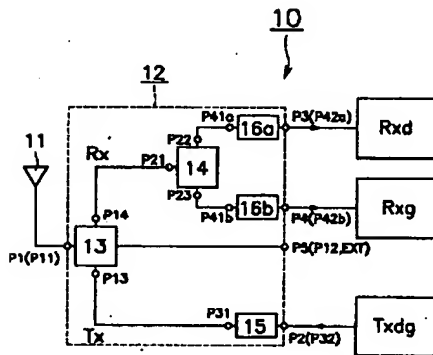
キャパシタンス素子

D1~D4 スwitchング素子

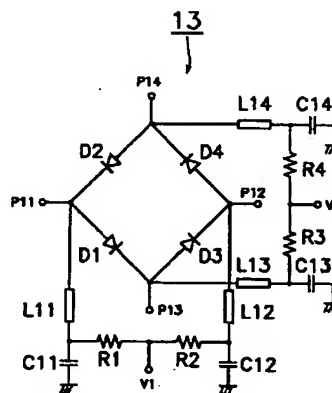
DCS, GSM 通信システム (DCS系、GSM系)

10 L11~L14, L21, L22, L31 インダクタ素子

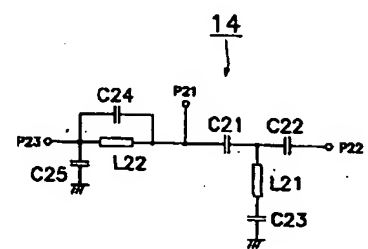
【図1】



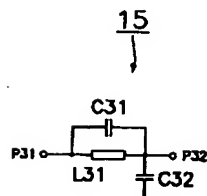
【図2】



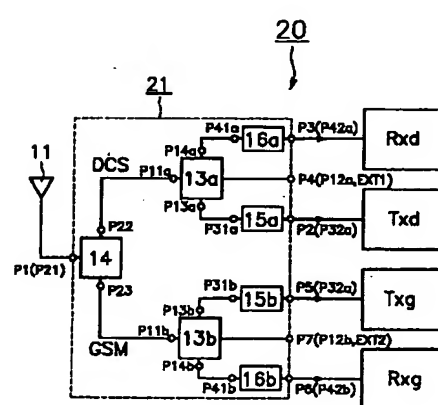
【図3】



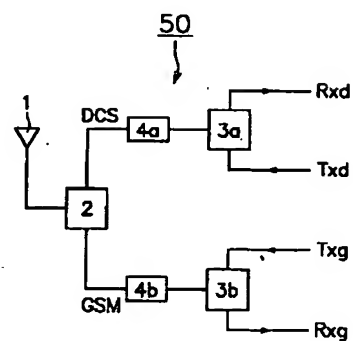
【図4】



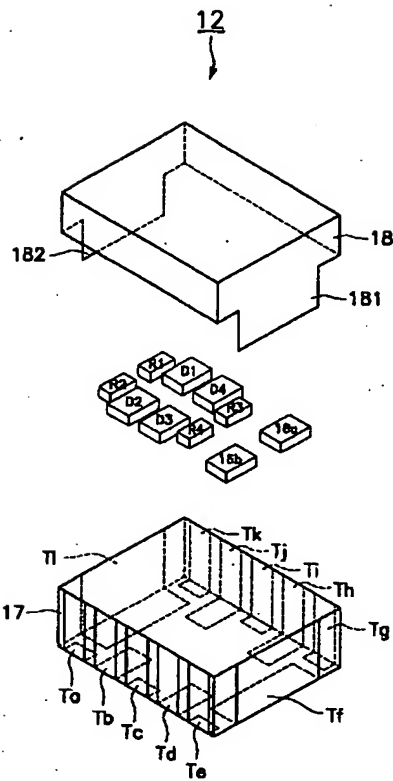
【図6】



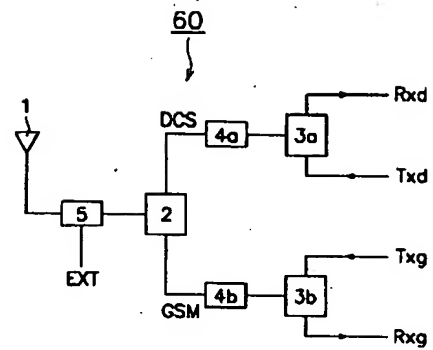
【図7】



【図5】



【図8】



フロントページの続き

(72)発明者 武藤 英樹  
京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式  
会社村田製作所内  
(72)発明者 上嶋 孝紀  
京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式  
会社村田製作所内

(72)発明者 中島 規巨  
京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式  
会社村田製作所内  
Fターム(参考) 5J006 KA02 KA24 LA21 LA24 PA03  
PB03  
5J012 BA03  
5K011 AA16 DA02 DA21 DA27 JA01  
KA12